

PCN # 20141208000A
一部製品組立サイト移行(from Amkor-K1 to Amkor-P1)

お客様各位

Revision A は、部材(included BOM)比較表を訂正する変更記載更新のためのものです。ご迷惑をお掛けして申し訳ございません。

Amkor-K1 社(Korea)サイトが 2015 年までに閉鎖されます。今回のお知らせは、QFN パッケージ製品の代替サイトへの移行 support の連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

お客様におかれましては、本通知発行日後、30 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、30 日以内にご連絡が無い場合には、本変更をご承認いただけたものと判断させていただきます。変更品評価用サンプルもしくは追加データご入用の場合には、お客様評価完了を確実にし、Amkor-K1 社サイト閉鎖前に新サイトへの移行を完了するためにも、本通知初版発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知初版発行日より 90 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではありません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはありません。

尚、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

PAGE 2:

Attachment: 1

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。変更内容詳細は下記を参照ください。

PCN 番号:	20141208000A	PCN 日付:	02/06/2015																								
表題:	一部製品組立サイト移行(from Amkor-K1 to Amkor-P1)																										
PCN 詳細																											
変更内容:																											
Revision A は、下記の通り下記部材(included BOM)比較表を訂正する変更記載更新のためのものです。ご迷惑をお掛けして申し訳ございません。 Group 1: - Amkor-K1 社及び Amkor-P1 社サイト間でチップ接着剤(Mount Compound)の相違はありません。 - モールド樹脂(Mold compound)の部材番号更新します。 - Amkor-P1 社サイトにおける Au(金)ワイヤオプションを削除します。 Group 2: Amkor-K1 社及び Amkor-P1 社サイト間で部材の相違はありません。 一部製品について、組立サイトが、Amkor-K1 社から Amkor-P1 社サイトへ移行します。部材の相違は下記の通りです。 Group 1 Device <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Amkor K1</th> <th>Amkor P1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mount Compound</td> <td>101361223</td> <td>4208458</td> </tr> <tr> <td>Mold Compound</td> <td>101319571</td> <td>4211649 101377289</td> </tr> <tr> <td>Wire type</td> <td>Au</td> <td>Au, Cu</td> </tr> <tr> <td>Lead Finish</td> <td>Matte Sn</td> <td>NiPdAu</td> </tr> </tbody> </table> Group 2 Device <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Amkor K1</th> <th>Amkor P1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mount Compound</td> <td>101361223</td> <td>4208458</td> </tr> <tr> <td>Mold Compound</td> <td>101319571</td> <td>4211649</td> </tr> </tbody> </table> 変更理由: Amkor-K1 社組立サイト閉鎖、供給確保 外観, 寸法, 機能, 品質, 信頼性(positive / negative)に関する懸念事項: なし None.					Amkor K1	Amkor P1	Mount Compound	101361223	4208458	Mold Compound	101319571	4211649 101377289	Wire type	Au	Au , Cu	Lead Finish	Matte Sn	NiPdAu		Amkor K1	Amkor P1	Mount Compound	101361223	4208458	Mold Compound	101319571	4211649
	Amkor K1	Amkor P1																									
Mount Compound	101361223	4208458																									
Mold Compound	101319571	4211649 101377289																									
Wire type	Au	Au , Cu																									
Lead Finish	Matte Sn	NiPdAu																									
	Amkor K1	Amkor P1																									
Mount Compound	101361223	4208458																									
Mold Compound	101319571	4211649																									

注記)

1. 本資料は英語原文(一部)の日本語訳になりますが、TI の公式文書はあくまで英語原文になります。英語原文と日本語訳に齟齬がある場合には、英語原文が優先されます。
2. 上記項目以外、本資料に日本語訳が記載されていない項目については英語原文を参照ください。

原文のみ記載の項目例:

- **Proposed 1st Ship Date** (変更品出荷開始予定日)
- **Last date to order / Last date to ship** (最終受注日/最終出荷日)
- **Estimated Sample Availability** (サンプル入手可能予定時期)
- **Change Type** (変更項目タイプ)
- **Changes to product identification resulting from this PCN** (本変更による製品識別の変更)
- **Product Affected** (対象製品)
- **Qualification Data** (認定試験データ)
- **Appendix** (付属資料) 等